

证券代码：605358

证券简称：立昂微

杭州立昂微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-007

投资者关系 活动类别	●特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □电话会议 □其他
时间	2025 年 11 月 1 日 11:00-13:00 君晟研究、南华基金、鹏扬基金、恩宝资管、紫阁投资、财通证券、君富投资、宽渡资产、浙江新质生产力研究院、中域资产、湘财基金、深圳汇合创世投资、永望资产、泰信基金、太平基金、民生资管、浦银安盛基金、成都鑫元和盛投资、伏明资、国泰海通、广发证券分公司、山伦咨询、紫莺资产、益恒投资、君万资本、光大证券、科领资本、乐信投资、君和资本、非马投资等 35 人；
上市公司接 待人员姓名	董事长：王敏文 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云
投资者关系 活动记录	董事长王敏文就公司的发展历程、主营业务、竞争优势、产业应用等向与会投资者做了详细的介绍，董事会秘书吴能云就公司的未来发展规划作了系统说明。 公司投资者交流的问题回复内容如下： 1.轻掺硅片是否比重掺硅片更有技术含量？ 答：公司半导体硅片产品中既有轻掺硅片又有重掺硅片，轻掺硅片和重掺硅片各有技术特点。轻掺硅片和重掺硅片属于两种不同的应用场景，从单晶晶体生长环节就已经有明显的区分，轻掺硅片主要应用于存储、逻辑芯片，重掺硅片主要应用于功率、模拟芯片。首先，半导体硅片的核心工艺是晶体生长环节，就晶体生长环节而言，轻掺硅片的难点在于缺陷控制，因为逻辑、存储芯片使用的硅片是批量化的，只要达到客户要求可以大批量复制。重掺硅片的难点在于如何降低电阻率，因为功率、模拟芯片是偏定制化的，每家客户每项产品对于硅片的要求都不同，这二者相比在晶体生长环节重掺硅片更难，要保证不同的掺杂可以满足不同客户的多样化需求。轻掺硅片因为下游应用场景的因素，市场关注度较高，但无论轻掺、重掺硅片都具有很高的技术含量，都以满足国产化需求为目标。 2.公司硅片是否面临价格战？

	答：公司的发展策略长期以来注重差异化竞争，更关注产品的技术、质量优势而非价格优势，因此发展至今公司半导体硅片、半导体功率器件芯片、化合物半导体射频和光电芯片三项主营业务在细分领域都拥有较强的竞争优势。从半导体硅片产品看，公司的优势在于重掺硅片的技术，部分技术可保持全球同步领先，在该领域公司不会去进行价格竞争，未来公司半导体硅片也会继续走差异化竞争路线，发挥重掺产品的技术优势。与此同时轻掺硅片的价格竞争相对激烈，公司也会在产能持续爬坡的基础上，持续投入先进制程用轻掺硅片的研发，满足客户的需求。 3.芯片涨价是否会带动硅片涨价？ 答：半导体行业的价格周期一般从下游逐步往上游传导，如芯片涨价传导到半导体硅片涨价往往需要半年的时间。目前公司重掺硅片因订单充足，出货量同比、环比均有大幅增长。在此情况下，公司优先选择高价值量产品订单，公司因出货结构的变化单片价格已有所提高。 4.今后几年的资本开支是如何规划的？ 答：公司半导体硅片业务板块的在建项目主要有衢州基地的可转债募投项目“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”，另外还有嘉兴基地“年产96万片12英寸硅外延片项目”，主要为满足客户对于硅片生长外延的需求，会根据产能爬坡和客户需求适当调节建设进度。功率半导体芯片业务板块暂无大额资本开支计划，将主要侧重产品结构的优化，增加汽车电子、FRD等高价值产品的占比；化合物半导体射频和光电芯片业务板块方面，海宁立昂东芯厂房已全部建成，目前年产6万片的产能已经投产，暂无大额资本开支计划，将主要侧重海宁立昂东芯的产能爬坡和增加VCSEL、航空航天等高价值产品的占比。 5.公司硅片业务固定成本费用摊销对毛利率的影响如何？ 答：公司硅片业务板块中折旧摊销、电费、人工成本三项固定成本占硅片营业成本的2/3，硅片产品出货量的快速爬坡会使单位产品分摊固定成本大幅下降，迅速提升毛利率。 6.公司既有硅片业务，又有功率器件芯片业务，公司如何与硅片客户避免竞争？ 答：公司硅片业务在重掺硅片领域具有竞争优势，公司硅片基本覆盖了绝大部分功率芯片客户。公司功率芯片为6英寸产品，主要用于新能源、汽车电子等细分领域，功率芯片种类繁多，公司与硅片客户的功率芯片产品各有所长，仅与少量客户存在重叠。
--	--